

MEXTAGE

第53期 中間 株主通信

2021年1月1日から2021年6月30日まで

経営理念

わたしたちは「独創の技術」「信頼の品質」「万全のサービス」を信条に、自由に着想し、グローバルな事業活動を通して界面価値創造を実現することで豊かで潤いのある社会と環境づくりに貢献します。

P.1 2021年 中間期の業績振り返りと今後の事業戦略

P.3 2021年 中間期の業績を教えてください

P.4 当社と半導体・電子基板の関わり
～関係性と最新動向～

P.5 財務指標

P.6 会社概要、株式の状況

界面価値創造

CREATING AND FOSTERING VALUE
AT VARIOUS INTERFACES



社長に聞く!

2021年 中間期の業績振り返りと
今後の事業戦略

半導体需要 拡大の潮流を背景に、 新たな成長ステージへ。



コロナ禍でのDX 推進、新生活様式への対応で、 サーバー・パソコン・タブレット端末・ モニター需要が伸長

コロナ禍により在宅勤務・学習の導入やデジタルトランスフォーメーション(DX)への投資、新しい生活様式への対応が進み、パソコン、タブレット端末、モニター需要が引き続き右肩上がりに。データ量の増大や5G切り替えを背景としたサーバー需要も引き続き増加し、当社グループの業績は好調に推移しました。自動車業界等で一部、半導体供給不足の影響が見られましたが、半導体市場全般に大型投資が進みました。とりわけ当社と関わりの深いハイエンドな半導体を搭載するパッケージ基板やマザーボード、高周波基板、アンテナ基板の需要が拡大。今後、5G関連の投資がさらに進み、自動運転も進展すると、当社グループの製品、技術を活かせる分野や需要もますます拡大する見込みです。そのなかで当社は新たな成長のステージを目指してまいります。

ネットワーク関連需要で密着向上剤 「CZシリーズ」が好調。 新規アプリケーションでも採用進む

IoT・AI・5Gの進展を背景に、データセンターやエッジコンピューティングのサーバー向けに、高性能パッケージ基板の需要がさらに高まり、ハイエンド分野で高いシェアを持つ当社の密着向上剤「CZシリーズ」の拡販が進みました。また、粗化能力をさらに高めたCZの新製品も、サーバーやスマートフォン向けに採用が進みました。

タッチパネル向け「SFシリーズ」が好調。 エッチング剤「EXEシリーズ」も伸長

タッチパネルセンサーに使用される「SFシリーズ」は、業ごもりによるタブレット端末需要が伸びたことから前期からの好調を維持しました。ディスプレイ向けCOFの回路配線形成で高いシェアを持つ「EXEシリーズ」は、より多くのCOFを使用する4K8Kテレビの出荷台数が伸びたことから堅調を維持しました。

新型コロナへの対応と新しい働き方

社内における新型コロナウイルス感染症への対応としては、基本的な対策をしっかりと行い、従業員の安心安全を確保したうえで顧客への供給責任等、企業の社会的責任を果たしてきました。従業員への「在宅勤務」「フルフレックス」の推奨とともに、営業・事務職のテレワーク活用、リモートによる対顧客技術サポートへの注力等、時勢に即した新しい働き方の導入を積極的に進めています。

代表取締役社長

前田和夫



→ 詳細はホームページ掲載の決算短信をご覧ください。
www.mec-co.com/ir/library/

2021年 中間期のポイント

押さえておきたい2021年 中間期のポイントを2ポイントにまとめています。ぜひ参考にしてください。

1 コロナ禍対応による PC・タブレット端末・サーバー需要増で増収増益に

2 パッケージ基板生産の急増で「CZシリーズ」売上が引き続き好調

2021年 中間期の実績

	2020年 12月期 中間期	2021年 12月期 中間期	増減
	2020年1月1日~ 2020年6月30日	2021年1月1日~ 2021年6月30日	
売上高 (百万円)	5,701	7,024	23.2% 増 ↑
営業利益 (百万円)	1,133	1,949	72.0% 増 ↑
経常利益 (百万円)	1,126	2,023	79.6% 増 ↑
親会社株主に 帰属する四半期 純利益 (百万円)	794	1,466	84.7% 増 ↑
1株当たり 四半期純利益 (円)	41.85	77.25	

用語解説

■ デジタルトランスフォーメーション (DX: Digital transformation)

デジタル(IT)技術による生活やビジネスの変革

■ エッジコンピューティング

利用者や端末の近くに処理装置(エッジプラットフォーム)を分散配置して、ネットワークの端点でデータ処理を行う技術

■ アンテナ基板

高周波信号の伝送に用いる高周波基板。第5世代移動通信システム(5G)のキーデバイスの一つ

グローバル戦略について

当社のグローバル戦略は、これまで国内の生産機能をそのまま海外に移管する方針で展開してきましたが、近年は国際関係や規制が複雑化し、材料調達の重要性が高まり、サプライチェーン再編の動きも見られます。そこで当社のアジアや欧州を中心にしたネットワークを活かして、柔軟に対応できるグローバル調達・供給体制の整備を進めていく考えです。なお、2019年9月から稼働しているタイの子会社は、当社製品の現地生産化も進み、東南アジア地域のハブ拠点として、本格的な活動を開始する予定です。

今後の投資計画、研究開発について

当社のコア技術「密着性向上」に磨きをかける投資とともに、半導体の微細化や熱効率向上等、エネルギー効率に寄与する技術への投資、そして今後はIoTやAIに関連した投資が重要になると考えています。これらの技術を活用すれば、これまでとは異なるかたちで当社コア技術を展開する可能性も広がるからです。研究開発投資につきましては、従来どおり連結売上高の約10%の先行投資を維持し、競争力のある新製品開発に取り組んでまいります。

通期見通しと配当政策について

マクロな状況から判断して、当社をめぐる事業環境の大きな変動は考えにくいと見ていますが、当期後半は社内各部門で人材強化を行うことから、それら人件費等を踏まえた利益計画としております。配当につきましては、安定配当の考え方を維持しつつ、指標として連結配当性向30%を念頭においています。

株主の皆様へのメッセージ

新型コロナウイルスの感染拡大で、社会生活や経済活動が様変わりするなか、当社の事業活動もフェーズが変わりつつあると見て、将来に向けたさまざまな取り組みを進めています。当社技術は5Gの普及拡大への貢献のみならず、省エネやCO₂削減といった社会課題解決にも寄与できると確信し、当社製品に対するニーズはさらに高まると考えております。今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

業績の推移および セグメント別販売動向について

Q 当中間期の事業環境と業績について教えてください

A サーバー・パソコン・タブレット・モニターの需要が引き続き堅調

エレクトロニクス業界は、世界各国で加速する在宅勤務、新しい生活様式への対応等の影響や、これに伴うデータ量の増加、5Gへの切り替えを背景に、サーバーやパソコン、タブレット端末、モニター向け需要が堅調に推移。とりわけ半導体を搭載するパッケージ基板において需要が拡大しました。一方、自動車用、産業用をはじめ世界的に半導体供給不足の影響が見られましたが、業界全体で積極的な大型投資が進みました。このような環境のもと、当社グループは高密度電子基板向け製品の開発、販売に注力いたしました。超粗化系密着向上剤「CZシリーズ」は強い半導体需要を背景に、ディスプレイ向け「EXEシリーズ」も関連する電子機器の需要により、ともに大きく増加しました。「SFシリーズ」は関連する電子機器が半導体不足の影響で一時生産調整がありましたが、好調な結果となりました。多層電子基板向け密着向上剤「V-Bondシリーズ」は、関連する自動車市場が復調した影響で、大きく回復いたしました。その結果、当中間期の売上高は70億24百万円(前年同期比23.2%増)、営業利益は19億49百万円(同72.0%増)、売上高営業利益率は27.8%(同7.9ポイント増)、経常利益は20億23百万円(同79.6%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は14億66百万円(同84.7%増)となりました。

Q 製品別の販売状況を教えてください

A CZはじめ主要製品は全て好調でした

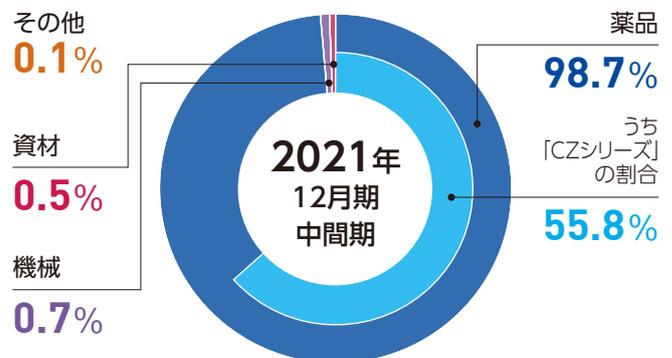
「CZシリーズ」の売上高は38億71百万円(前年同期比29.1%増)、薬品売上高に占める割合は55.8%(同1.2ポイント増)でした。「EXEシリーズ」は8億56百万円(同29.0%増)、「SFシリーズ」は5億68百万円(同18.0%増)、「V-Bondシリーズ」は3億71百万円(同22.8%増)でした。

Q 地域別の販売動向はいかがでしたか?

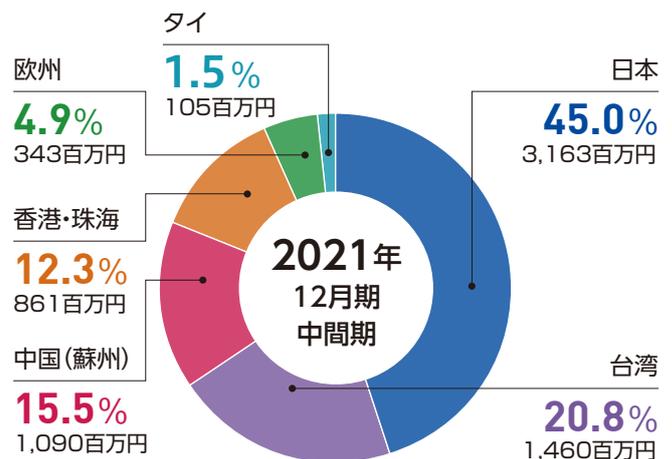
A 全ての地域で売上が増加しました

地域別売上高(連結)における海外売上高比率は56.5%(前年同期比5.1ポイント増)となりました。国内はパソコンやサーバー関連製品、台湾はサーバーやモニター関連製品が引き続き好調。香港は自動車関連製品が引き続き伸長し、タブレット端末関連の製品生産が中国(蘇州)から移管されて売上が好調。中国は春節期間中の一部顧客における生産稼働の影響があったため順調に推移。欧州は顧客の生産活動に持ち直しの傾向が見られ、堅調でした。

売上高に占める品目別割合 (%)



地域セグメント別売上高比率 (%) / 売上高 (百万円)



当社と半導体・ 電子基板の関わり

パソコン等の電子部品の品質を向上させるためにメックの製品が使われています。

高性能パッケージ基板向けで、 CZの使用量も増加傾向に

当社の主力製品「CZシリーズ」は、電子基板上の回路（銅）表面をざらざらに加工することで、基板材料である樹脂との密着性を高める表面処理剤です。密着性の向上で熱による電子基板の故障を防ぐことができるため、品質・信頼性の向上を目的として、パソコン、サーバー、スマートフォン等、世界中のパッケージ基板の製造に使用されています。

現在、世界中でネットワーク技術がますます高度化し、それに伴いデータ通信に欠かせないサーバーの高機能化が顕著に進んでいます。サーバーの性能を向上させる方法として、従来は1つのパッケージ基板に1つの半導体が搭載されていましたが、1つのパッケージ基板に複数個の半導体が搭載されるようになってきました。このことで、パッケージ基板が大きくなり、CZで処理される面積が広がるため使用量も増加する傾向にあります。

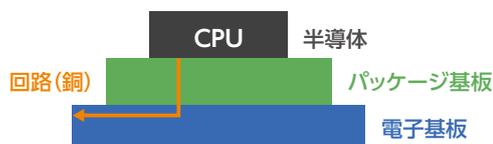
デジタル社会の進展で、 さらなるCZの活躍に期待

今後も5G、ビッグデータ、AI、自動車の自動運転等、ICT技術の進展が望まれる中、それらを支える重要基盤である半導体市場もますます高度な技術が求められ、さらに市場が成長・拡大していくと考えられています。そのような市場において、「CZシリーズ」は高品質なネットワーク環境を実現するために必要不可欠な製品となり、需要も高まりつつあります。近年では売上高は増加傾向にあり、今後もその動向は続くと思料しています。

当社はこれからも、「CZシリーズ」を中心に情報インフラを支え、社会に貢献する製品を提供していきます。

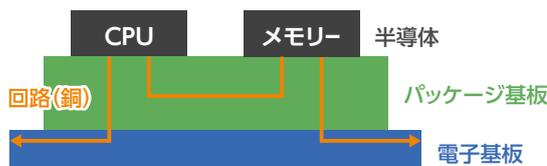
従来パッケージ基板と最新パッケージ基板の比較

従来のパッケージ基板



1つのパッケージ基板に、1つの半導体部品（CPU、メモリー）を搭載

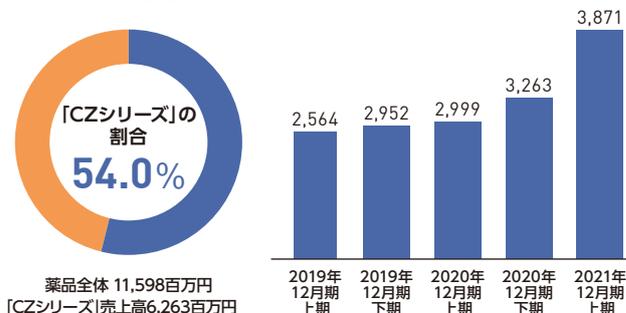
最新のパッケージ基板



1つのパッケージ基板に複数の半導体部品（CPU、メモリー）を搭載

「CZシリーズ」の売上動向

■ 薬品売上高に占める割合 (2020年12月期) ■ 「CZシリーズ」の売上・予想(百万円)

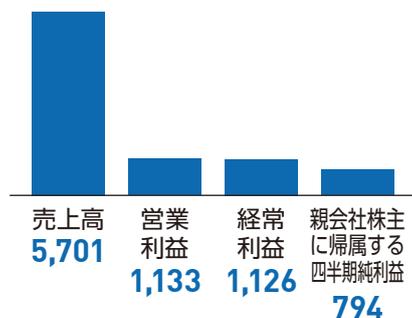


「CZシリーズ」は当社の主力製品
今後も売り上げが増加すると予想しています

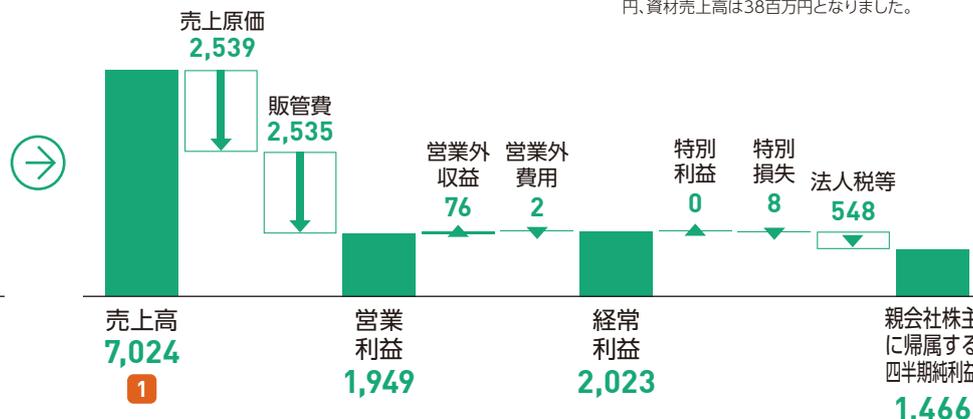


連結損益計算書の概要 (百万円)

2020年12月期 中間期
 (2020年1月1日～2020年6月30日)



2021年12月期 中間期
 (2021年1月1日～2021年6月30日)

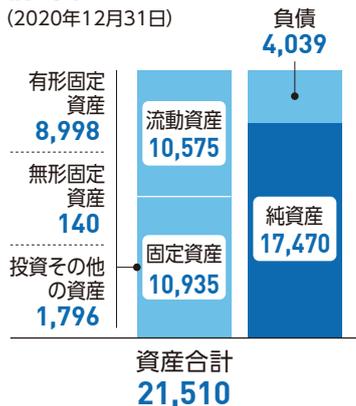


1 売上高

薬品売上高は69億33百万円、機械売上高は50百万円、資材売上高は38百万円となりました。

連結貸借対照表の概要 (百万円)

前期末
 (2020年12月31日)

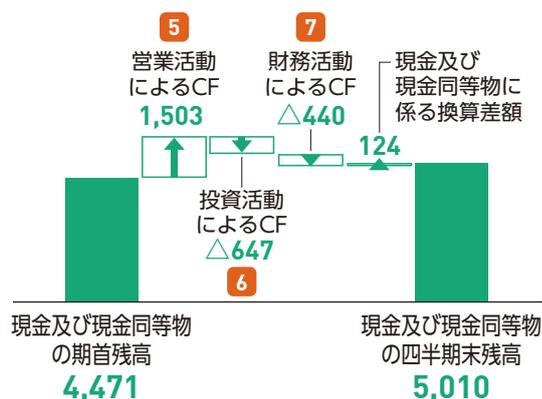


2021年12月期 中間期
 (2021年6月30日)



連結キャッシュ・フロー計算書の概要 (百万円)

2021年12月期 中間期
 (2021年1月1日～2021年6月30日)



2 負債

負債は、短期借入金や未払金の減少等により、前連結会計年度に比べて3億16百万円減少し、37億23百万円となりました。

3 純資産

純資産は、利益剰余金や為替換算調整勘定の増加等により、前連結会計年度に比べて17億48百万円増加し、192億19百万円となりました。

4 資産合計

資産合計は、増収による現金及び預金や、受取手形及び売掛金の増加等により、前連結会計年度に比べて14億32百万円増加し、229億43百万円となりました。

5 営業活動によるCF

営業活動の結果得られた資金は15億3百万円。これは主に税金等調整前四半期純利益が20億15百万円、減価償却費が3億57百万円、たな卸資産の増加が2億66百万円、法人税等の支払額が4億36百万円あったこと等によるもの。

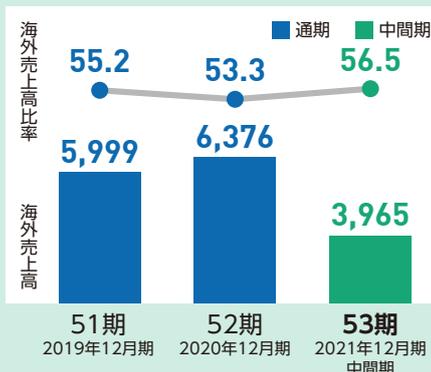
6 投資活動によるCF

投資活動の結果使用した資金は6億47百万円。これは主に有形固定資産の取得による支出が4億66百万円あったこと等によるもの。

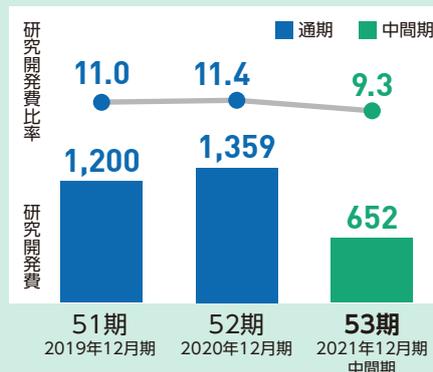
7 財務活動によるCF

財務活動の結果使用した資金は4億40百万円。これは主に短期借入金の返済による支出が2億円、配当金の支払いが2億68百万円あったこと等によるもの。

海外売上高(百万円)／比率(%)



研究開発費(百万円)／比率(%)



1株当たりの配当金(円)





メック株式会社

本社事務所 / 〒660-0822 兵庫県尼崎市杭瀬南新町三丁目4番1号
 TEL. 06-6401-8160 FAX. 06-6401-8165
 URL www.mec-co.com/

株式に関する住所変更等のお手続きについてのご照会

1. 証券会社の口座をご利用の株主様は、三井住友信託銀行株式会社ではお手続きができませんので、取引証券会社へご照会ください。
2. 証券会社の口座をご利用でない株主様は、上記電話照会先※までご連絡ください。



株主メモ

事業年度	毎年1月1日から12月31日まで
期末配当金 受領株主確定日	毎年12月31日
中間配当金 受領株主確定日	毎年6月30日
定時株主総会	毎年3月
単元株式数	100株
株主名簿管理人 および特別口座 の口座管理機関	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
株主名簿管理人 事務取扱場所	大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
郵便物送付先	三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
電話照会先※	TEL. 0120-782-031 (通話料無料)
インターネット ホームページURL	www.smtb.jp/personal/agency/index.html
上場証券取引所	東京証券取引所市場第一部
証券コード	4971

公告の方法 電子公告により行う。
 公告掲載URL www.mec-co.com/ir/denshi/
 (ただし、電子公告によることができない事故、その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。)

株主優待情報

保有株式数	優待内容	*毎年12月31日現在の株主名簿に記載または記録された当社株式100株(1単元)以上保有の株主様を対象といたします。
1,000株未満	QUOカード 1,000円分	
1,000株以上	QUOカード 2,000円分	

ニュースメール配信サービスのご案内

当社では、ホームページにニュースリリースや新しいコンテンツが掲載された際に、ご登録者の皆様にそのタイトルとURLを電子メールにてお知らせするサービス(ニュースメール配信サービス)を行っています。
 ご希望の株主様には、こちらのサービスの送信先メールアドレス(携帯電話のメールアドレス不可)を、当社ホームページまたは、RIMSNET(rims.tr.mufig.jp/)から、簡単にご登録いただけます(無料)。

アンケートのお願い

当社では、株主の皆様とのよりよいコミュニケーションを目指し、今後も業績情報の開示の充実に努めていきたいと考えています。
 つきましては、この株主通信に対するご意見、ご感想をお聞かせいただきたくアンケートにご協力をお願いいたします。
 ※ご提供いただきました情報は、本アンケートの集計の目的以外に使用することはありません。

ホームページのご紹介

www.mec-co.com/

当社のホームページでは
 プレスリリース、株主通信、コーポレート・ガバナンス報告書 他
 各種情報を掲載しています。ぜひご覧ください。



株価の推移 (2020年8月~2021年7月)

(単位: 円)

